中国国际金融股份有限公司

关于龙迅半导体(合肥)股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"龙迅股份"、"公司")持续督导工作的保荐机构,负责龙迅股份的持续督导工作,并针对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 2 月 31 日(以下简称"报告期")经营情况,出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度,并制定了相应的工作 计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确 双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交 易所备案	保荐机构已与龙迅股份签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不 定期回访等方式,了解龙迅股份业 务情况,对龙迅股份开展持续督导 工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规 事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易 所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上 公告	在持续督导期间龙迅股份未发生 按有关规定需保荐机构公开发表 声明的违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施	在持续督导期间龙迅股份未发生 违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的	在持续督导期间,保荐机构督导龙 迅股份及其董事、监事、高级管理 人员遵守法律、法规、部门规章和

序号	工作内容	持续督导情况
	各项承诺	上海证券交易所发布的业务规则 及其他规范性文件,切实履行其所 作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度, 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促龙迅股份依照相关 规定健全完善公司治理制度,并严 格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、控股子公司管理等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对龙迅股份的内控制度 的设计、实施和有效性进行了核 查,龙迅股份的内控制度符合相关 法规要求并得到了有效执行,能够 保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度, 审阅信息披露文件及其他相关文件, 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促龙迅股份严格执行 信息披露制度,审阅信息披露文件 及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对龙迅股份的信息披露 文件进行了审阅,不存在应及时向 上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上 海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具 监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度, 采取措施予以纠正	本持续督导期间,龙迅股份及其控 股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行 承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等 未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间,龙迅股份及其控 股股东、实际控制人不存在未履行 承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场 传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露 未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的, 及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司 不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易 所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司作出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他	本持续督导期间,龙迅股份未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构制定现场检查的相关工 作计划,并明确了现场检查工作要 求
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	本持续督导期间,龙迅股份不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下:

(一)核心竞争力风险

1、技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集型的特征,市场需求的不断升级、产品技术的持续迭代是行业的发展重要规律。公司主营业务所在的高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片细分领域的技术与方案伴随着终端需求的变化也不断推陈出新。公司需要持续不断地推出符合技术发展方向与市场需求趋势的新产品才能维持并提升公司的竞争力。如果未来公司技术迭代创新和产品升级换代未达到预期,难以满足市场需求的最新变化,可能会使得公司在市场竞争中处于不利地位,逐渐丧失市场竞争力,对公司未来业务发展造成不利影响。

2、研发失败风险

公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片的研发设计与销售。公司需要结合技术发展和市场需求确定研发方向,持续进行现有产品线的升级与新产品的开发,以适应不断变化的市场需求,并持续投入大量的资金和人员进行研发。由于新技术与产品的研发与产业化具有一定的不确定性,如果公司的研发创新方向与行业发展趋势出现较大偏离,或相关研发成果短期内无法产业化,公司将面临研发失败的风险,将对公司经营业绩产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过十多年来持续的技术积累,公司储备了一系列拥有自主知识产权的核心技术。如未来因研发人员流失、关键信息泄露、核心技术保管不善等因素导致核心技术泄密,将对公司业务造成不利影响。

(二) 经营风险

1、市场竞争加剧风险

公司业务所处领域整体有较高的技术壁垒,需要长时间的技术积累,而中国大陆企业在该领域起步相对较晚,目前市场竞争格局仍主要由境外公司所主导,公司各类产品目前国产化率尚处于较低水平。公司相较于海外领先竞争对手,在整体规模、研发实力、营销网络、客户资源、融资渠道等诸多方面仍存在差距。同时,随着中国半导体产业整体设计能力的进步,公司也会面临本土芯片设计公司在细分产品市场的竞争。在日趋激烈的市场竞争环境下,若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势,不能根据客户需求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量,竞争决策失误、市场拓展不力,则公司的市场地位与经营业绩等可能受到不利影响。

2、贸易摩擦及贸易政策变动风险

报告期内,公司境外销售比例较高,主要集中在中国香港、中国台湾、韩国、日本等国家或地区。同时,公司晶圆制造及封装测试境外采购比例高,主要集中在马来西亚、中国台湾。未来如果全球贸易摩擦加剧,相关国家或地区采取限制性的贸易政策,境外客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相关关税等措施,境外供应商可能会被限制或禁止向公司供货,上述情况会对公司的正常生产经营产生不利影响。

3、供应商集中度高风险

公司采用 Fabless 经营模式,专注于芯片的研发设计和销售,生产环节主要委托 晶圆生产厂和封装测试厂进行制造加工。报告期内,公司向前五名供应商采购金额 占同期采购总额的比例相对较高,供应商整体集中度较高;其中,境外晶圆供应商主要有 Silterra 和联华电子,境外封测供应商主要有超丰电子,境外供应商占比及集中度较高。未来若公司合作的主要供应商因贸易摩擦、排期紧张或者关系恶化等各种原因不能如期、足量供货,从而对公司生产经营造成不利影响。

4、客户相对集中风险

报告期内,公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,客户集中度较高。如果未来公司主要客户的经营、采购战略产生较大变化,或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户,或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,将对公司经营产生不利影响。

(三) 财务风险

1、收入波动及未来业绩快速增长不可持续的风险

公司业务规模增长受下游需求增长影响较大,若整体宏观经济及半导体行业持续波动、产业政策发生重大不利变化,公司产品涉及的安防监控、教育及视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边等下游应用需求下降,公司未能及时判断下游需求变化,可能对公司的销售收入和经营业绩产生不利影响。同时,产品和技术升级迭代及市场竞争格局变化也将对公司业绩产生影响,若公司技术实力停滞不前、市场竞争加剧或市场环境发生重大不利变化,可能导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形,公司存在未来业绩快速增长不可持续、业绩大幅波动或下滑的风险。

2、毛利率波动风险

公司产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本、公司设计能力、竞争格局等多种因素影响,若上述因素发生不利变动,可能导致公司毛利率下降,从而影响公司盈利能力。

3、存货余额较大及减值风险

公司产品品类丰富、应用领域广泛、生产周期较长等因素决定公司需保持较高规模的存货储备。公司存货的账面价值金额较大,如果下游市场需求下降或晶圆等原材料价格出现大幅下跌,公司将面临大幅计提存货跌价准备的风险,导致公司经营业绩下滑,给公司生产经营和财务状况带来不利影响。

(四) 行业风险

公司处于集成电路设计行业,半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征,与宏观经济及下游应用市场需求波动有较大关联,同时国家政策对行业的发展亦有较大影响。如果未来半导体行业周期出现波动较大的情况,则可能将对公司的经营业绩造成不利影响。同时,半导体行业是国民经济和社会发展的战略性产业,国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体行业的发展,增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱,将对公司发展产生一定影响。

(五) 宏观环境风险

1、全球贸易摩擦风险

近年来,全球贸易摩擦频发,而公司的客户、供应商、EDA 工具授权厂商大多为境外企业,虽然目前未对公司的经营情况产生重大不利影响,但鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业,如果全球贸易摩擦进一步升级,有可能造成产业链上下游交易成本增加,下游需求受限,上游供给不畅,从而将对公司的经营造成不利影响。

2、税收优惠政策变动风险

报告期内,公司作为高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业,享受10%的企业所得税优惠税率。若国家相关税收优惠政策发生变化,或者公司未能持续获得高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业认定,则可能面临因税收优惠减少或取消而导致盈利能力下降的风险。

3、汇率波动风险

公司存在境外采购和销售,并通过美元进行结算。未来若人民币与美元汇率发生大幅波动以及未来公司经营规模持续扩大后以美元计价的销售额和采购额进一步增长,可能导致公司产生较大的汇兑损益,引起公司利润水平的波动,对公司未来的经营业绩造成不利影响。

(六) 其他重大风险

1、法律风险

(1) 知识产权相关风险

公司拥有的商标、专利等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。随着高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片及相关领域市场竞争日趋激烈,公司未来仍可能出现知识产权被第三方侵犯、知识产权涉及侵权诉讼或纠纷等情形。如果公司通过法律途径寻求保护,将为此付出额外的人力、物力及时间成本,从而导致公司商业利益受到一定程度的损失。如公司相关核心技术被竞争对手所获知并效仿,或者第三方侵犯公司知识产权的行为得不到及时防范和制止,可能对公司未来业务发展和生产经营产生负面影响。

(2) 产品质量相关风险

随着公司经营规模的持续扩大,对质量控制能力的要求逐步提高,如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施,公司产品出现质量问题,可能导致与客户发生潜在诉讼或纠纷,影响公司的市场地位和品牌声誉,进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、内控风险

(1) 经营规模扩大带来的管理风险

公司的经营规模持续扩大,随着公司业务持续发展和募投项目的实施,公司的收入和资产规模会进一步扩大,从而在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能及时调整、完善,公司将面临较大的管理风险。

(2) 内控制度建设和执行的风险

内部控制制度是保障企业财产与会计信息的完整性、安全性以及可靠性的关键制度。如果公司未来不能随着业务人员的发展而及时调整完善有关内部控制制度及体系,或者有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实,将影响企业管理的有效性,不利于维护公司财产安全并保持经营业绩的稳定增长。

3、预测性陈述存在不确定的风险

公司在 2024 年年报中所涉预测性的陈述,例如涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面的预期或相关讨论。尽管公司及公司管理层相信,该等预期或讨论所依据的假设是审慎和合理的,但亦需要提请投资者注意,该等预测性陈述仍有较大不确定性。鉴于该等预测与讨论均有风险及不确定性因素,本报告载明的任何预测性及前瞻性陈述,不应被视为本公司的承诺与声明。

4、股票价格波动风险

股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响,还会受到宏观经济基本面、资本市场资金供求关系、投资者情绪、国外经济社会波动等多种外部因素的影响。公司股票价格可能因上述而背离其投资价值,直接或间接对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

四、重大违规事项

2024年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	466,002,733.23	323,147,354.00	44.21
归属于上市公司股东的净利润	144,411,417.58	102,695,394.40	40.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	111,425,364.58	66,801,676.10	66.80

益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	116,888,052.59	103,412,018.58	13.03
归属于上市公司股东的净资产	1,431,799,478.55	1,429,466,358.91	0.16
总资产	1,502,359,846.45	1,486,536,902.57	1.06

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	1.42	1.05	35.24
稀释每股收益 (元/股)	1.42	1.05	35.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.09	0.68	60.29
加权平均净资产收益率(%)	10.22	8.45	增加 1.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.88	5.50	增加 2.38 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	21.45	23.06	减少 1.61 个百分点

2024年度,公司主要财务数据及指标变动的原因如下:

报告期内,公司实现营业总收入 46,600.27 万元,较上年同期增长 44.21%;归属于母公司所有者的净利润 14,441.14 万元,较上年同期增长 40.62%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,142.54 万元,较上年同期增长 66.80%。报告期末,公司总资产为 150,235.98 万元,较报告期初增长 1.06%;归属于母公司的所有者权益为 143,179.95 万元,较报告期初增长 0.16%。主要原因系报告期内,半导体行业呈现复苏迹象,下游客户需求有所增长,公司不断加强产品的迭代升级和新产品的研发力度、优化和完善现有产品的终端应用解决方案,满足终端客户不断衍生的新需求,积极拓展海内外市场,不断优化客户结构,实现了收入、利润的快速增长。

综上,公司 2024 年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

1、长期技术积累和持续创新能力优势

公司现有产品主要分为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片两大类。公司产品主要实现高清视频信号的桥接、处理、传输等功能,具有较高的技术门槛。

通过长期坚定的研发投入,公司在高速混合信号电路及芯片集成、高速数据传输芯片收发、高速接口传输协议处理兼容性、高带宽数字内容保护、高清视频及音频处理等方面积累了丰富的研发经验和技术能力,在高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片领域构筑了较强的竞争壁垒。上述技术优势使得公司在主流协议覆盖面与兼容性上具备国际竞争力,公司芯片产品线可覆盖市场绝大多数主流高清视频信号协议,可支持多个主流高清视频协议的业内最高版本,在其他主要功能上也具备一定的技术优势。

公司始终将研发创新能力视为企业发展的重要目标,持续创新能力是公司重要的竞争优势。为保持公司能够持续不断的进行技术创新,公司研发投入长期维持在较高水平。2024年,公司持续加大在各产品条线的研发投入,进一步提升研发平台硬件设施水平,壮大研发团队,优化组织架构,为产品升级及新品开发提供充分保障,全年累计投入9,996.86万元,较上年同期增加34.14%,占营业收入比重为21.45%。公司持续稳定的加大各产品领域的研发投入,为产品升级及新产品、新技术的开发提供有利保障,稳步提升公司的核心竞争力。同时,公司技术和产品创新以市场和客户需求为创新导向,建立了科学的项目开发和管理体系,制定了规范的知识产权管理制度,对人才培养、考核和激励进行了长远规划。这一系列的举措使得公司拥有了良好的持续创新机制,以在技术不断迭代的市场中保持竞争力。

2、结构丰富且具备市场竞争力的产品优势

公司成立以来始终以市场为导向,致力于提供高性能的高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片产品。通过多年市场耕耘,公司目前已拥有超过 140 款不同型号的芯片产品,产品普遍具有高集成度、高性能、低功耗的优势。公司多款高清视频桥接及处理芯片不仅支持上述信号协议之间转换,还集成了视频图像的分割、缩放、旋转、存储、压缩、解压、色彩空间转换与增强、显示控制,背光控制等处理功能,高速信号传输芯片在对各类信号高速传输的过程中,能实现中继、分配、切换和矩阵交换等功能,可为客户提供多样化的芯片解决方案。公司在高清视频桥接芯片与高速信号传输芯片产品上结构全面、功能丰富,可以满足下游客户对芯片产品高性能和高集成度的需要,具有较强的市场竞争力。

近年来,公司基于在相关细分领域的长期技术积累不断实现产品的高效迭代,

并根据对市场需求的深度理解持续提出具有创新性的芯片解决方案,不断丰富产品 线和优化产品结构,以维持并扩大在高清视频桥接芯片、高速信号传输芯片等细分 领域的产品竞争优势。

3、优质品牌价值与客户服务优势

公司通过多年来在高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片领域的持续深耕,已逐步在产业链内形成了优质的品牌声誉。随着公司芯片产品种类和规格的不断丰富、升级和系列化,可支持应用场景的不断多元化,公司的技术能力与产品性能正不断受到知名客户的广泛认可,客户结构持续优化。公司已成功进入国内外多家知名企业供应链。同时,随着技术能力的不断提升,公司积极与主芯片厂商进行沟通合作,以期更好把握行业前沿的技术趋势和市场机遇。目前,高通、英特尔、三星、安霸等多家世界领先的主芯片厂商已选择将公司的芯片产品纳入其参考设计平台。

公司高度重视加强规范管理和品质提升,以期为客户提供高品质的服务。公司拥有一支高技术水平、高执行力、高服务能力的现场技术支持团队,该团队对公司产品的性能、技术参数、新产品特性等都非常了解,能够及时主动的了解和响应客户的需求和产品使用中的痛点,并积极为市场迭代更为完善的解决方案,帮助公司迅速将产品导入市场。近年来,公司已逐步与众多下游知名客户建立了深度的合作关系。

4、管理与研发团队优势

公司高度重视管理与研发团队的建设和人才的培养。公司董事长 FENG CHEN 博士曾在英特尔公司任职,主要从事高速 CPU、I/O 等芯片设计工作。公司管理团队具有丰富的集成电路产业经验,具备扎实的专业能力和丰富的管理经验。公司自成立以来,在管理团队的带领下,获得了"国家鼓励的重点集成电路设计企业"、"国家重点'小巨人'企业"、"国家专精特新中小企业"、"高新技术企业"、"国家知识产权优势企业"等多项荣誉与资质。

公司研发团队由自公司核心创始研发团队和后期引进的具有丰富集成电路设计经验的研发人员组成。截至报告期末,公司共拥有176名研发人员,合计占员工总

数比例为 72.73%。自公司创立以来,在 FENG CHEN 博士的带领下,公司的研发能力、设计工艺和产品性能不断提升,积累了一系列核心技术。截至报告期末,公司已获得境内专利 114 项(其中发明专利为 92 项),境外专利 43 项(全部为发明专利),集成电路布图设计专有权 131 项,软件著作权 130 项。公司培养的富有创造力的高素质优秀人才队伍,为公司未来持续技术创新提供了强有力的支持。

5、精益求精的管理体系

公司按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格、完善的品质保障体系,并通过了国际通标认证公司 SGS 的管理体系认证。同时,为了提升管理水平,公司正在推进 Aspice《汽车软件过程改进与能力评定》管理体系、IATF16949 车载质量体系、ISO26262 汽车功能安全和 ISO27001 信息安全管理体系的建设工作。公司在产品的设计研发、晶圆制造、封装测试和成品管理等各个环节按照相应的质量保障流程和标准,由各部门负责人严格监督执行到位,以确保产品品质。

上述公司的核心竞争力在2024年度未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出及变化情况

报告期内,公司持续加大研发投入,以保持核心竞争力。研发投入总额 9,996.86 万元,较上年同期增长 34.14%,主要系研发人员增加及薪酬提高,同时根据公司股权激励计划,研发人员股份支付金额有较大幅度增长所致。

2、研发进展

公司坚持深耕于高速混合信号芯片领域,不断发展高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的技术并进行产品迭代,在高速混合信号电路及芯片集成、高速数据传输芯片收发、高速接口传输协议处理兼容性、高带宽数字内容保护、高清视频及音频处理等方面已掌握了多项国内领先或达到国际先进水平的核心技术。公司高度重视研究成果,不断通过申请专利和集成电路布图设计或制定严格的保密程序对技术予以保护。公司拥有的核心技术均通过自主创新形成,其中高速接口传输协议处理技术、高带宽数字内容保护技术达到国际先进水平,高速混合信号电路及芯片集成技术、高速数据传输芯片收发电路技术、高速混合信号芯片量产测试技术处

于国内领先水平,高清视频及音频处理技术处于国内先进水平。公司各项核心技术已全面应用在各主要产品的设计当中,实现了科技成果的有效转化。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计申请专利 212 项,其中发明专利 189 项,占比 89.15%;授权专利 157 项,其中发明专利 135 项,占比 85.99%。2024 年度,公司申请专利 4 项,其中发明专利 4 项;授权专利 15 项,其中发明专利 15 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 265,352,735.52 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,121,301,008.16
减:上市发行费用	91,020,020.91
其中:发行费用中置换前期已支付发行费金额	4,922,763.61
募集资金净额	1,030,280,987.25
减: 累计直接投资募投项目	160,933,898.49
其中: 本年度直接投资募投项目	92,369,112.32
置换前期投入募投项目	27,501,569.83
使用超募资金永久补充流动资金	43,000,000.00
其中: 本年度使用超募资金永久补充流动资金	21,500,000.00
报告期末现金管理余额	570,000,000.00
加: 累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额	36,507,216.59
其中: 本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	28,389,117.19
2024年12月31日募集资金专户余额	265,352,735.52

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人

民币 90,000.00 万元 (含本数) 的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-021)。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计 2,150.00 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额 7,233.03 万元的比例为 29.72%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-061)。报告期内,公司已使用 2,150.00 万元的超募资金永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

银行名称	账户	募集资金余额	
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	551903525810903	13,237,364.72	
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001930939	13,634,813.80	
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合 肥片区支行	1302011129100273322	42,053,115.55	
合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	20010339250866600000011	1,392,310.87	
杭州银行合肥分行营业部	3401040160001346585	195,022,771.84	
兴业银行合肥经开区科技支行	499110100100102427	12,358.74	
合计		265,352,735.52	

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等的持股、 质押、冻结及减持情况

1、持股情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股及相关变动情况如下:

姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	报告期内增减 变动(股)	增减变动原因
FENG CHEN	董事长、总经理、 核心技术人员	25,947,884	38,495,035	12,547,151	资本公积转增股本、 二级市场买入
吴文彬	独立董事(届满离任)、董事	-	-	-	/
陈来	独立董事	-	-	-	/
解光军	独立董事	-	-	-	/
苏进	董事、副总经理、 核心技术人员	224,400	340,992	116,592	资本公积转增股本、 第一类限制性股票 授予
王瑞鹍	监事会主席	-	-	-	/
杨家芹	监事	-	-	-	/
高云云	职工代表监事	-	-	-	/
刘永跃	董事(届满离任)、 副总经理	249,331	369,010	119,679	资本公积转增股本
赵彧	董事会秘书	-	-	-	/
韦永祥	财务负责人	-	-	-	/
夏洪锋	核心技术人员	224,400	252,078	27,678	资本公积转增股本、 二级市场卖出
贾冰雁	董事 (届满离任)	-	-	-	/
刘启斌	董事 (届满离任)	-	-	-	/
杨明武	独立董事(届满离任)	-	-	-	/
李晓玲	独立董事(届满离任)	-	-	-	/

除上述直接持股情况外,公司董事长、总经理、核心技术人员 FENG CHEN, 董事、副总经理、核心技术人员苏进,核心技术人员夏洪锋,监事高云云,高级管 理人员赵彧、韦永祥通过合肥芯财富信息技术中心(普通合伙)(以下简称"芯财富") 间接持有公司股票。报告期内,FENG CHEN 通过芯财富间接持有公司股票由 2.00 万股增加为 4.12 万股;苏进通过芯财富间接持有公司股票由 4.47 万股增加为 6.63 万股、夏洪锋通过芯财富间接持有公司股票由 4.73 万股增加为 6.98 万股、高云云通过芯财富间接持有公司股票由 2.29 万股增加为 3.41 万股、赵彧通过芯财富间接持有公司股票由 3.74 万股增加为 5.54 万股、韦永祥通过芯财富间接持有公司股票由 2.89 万股增加为 4.29 万股。

2、质押、冻结及减持情况

截至报告期末,公司控股股东、实际控制人及现任董事、监事和高级管理人员 持有的上述股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他 事项。 (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:

魏先勇

占海伟

